



RE900-01

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP I 28, 40, 48, 60 (0,40 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 29,29 x 43,64 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00